

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

須予披露交易 向中信銀行認購結構性存款產品

茲提述本公司日期為二零一九年六月十日、二零一九年七月二日、二零一九年九月九日、二零一九年十月二十一日及二零二零年一月二十日的公告（「該等公告」），內容有關華虹無錫作出的若干認購。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有上述該等公告所指定之涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年二月二十四日及二零二零年四月二十八日，華虹無錫已與中信銀行（無錫分行）訂立兩份額外結構性存款產品協議（分別為(i)「二零二零年二月中信結構性存款產品協議」及(ii)「二零二零年四月中信結構性存款產品協議」）。

中信銀行（無錫分行）之認購事項

二零二零年二月中信結構性存款產品協議之主要條款概要載列如下：

日期	:	二零二零年二月二十四日
訂約方	:	華虹無錫（作為認購方）與中信銀行（無錫分行）（作為銀行）
收益類型	:	保本浮動收益型
本金額	:	人民幣500,000,000元
期限	:	自二零二零年二月二十四日開始及於二零二零年六月十一日屆滿，為期108天

預期年收益率	：	介於1.50%至4.25%之間。實際收益率將參照以下條件釐定：
		(i) 倘二零二零年六月九日上午十一時正（倫敦時間）的3個月美元LIBOR小於或等於4.00%並且高於或等於0.20%，則預期年收益率將為3.75%；
		(ii) 倘二零二零年六月九日上午十一時正（倫敦時間）的3個月美元LIBOR高於4.00%，則預期年收益率將為4.25%；或
		(iii) 倘二零二零年六月九日上午十一時正（倫敦時間）的3個月美元LIBOR小於0.20%，則預期年收益率將為1.50%。
投資範圍	：	該產品為結構性產品，通過結構性利率掉期交易將全部資金用來投資運營。
提前終止	：	華虹無錫無權於到期日前撤回任何本金。
二零二零年四月中信結構性存款產品協議之主要條款概要載列如下：		
日期	：	二零二零年四月二十八日
訂約方	：	華虹無錫（作為認購方）與中信銀行（無錫分行）（作為銀行）
收益類型	：	保本浮動收益型
本金額	：	人民幣400,000,000元
期限	：	自二零二零年四月二十九日開始及於二零二零年六月三日屆滿，為期35天。
預期年收益率	：	介於1.50%至3.85%之間。實際收益率將參照以下條件釐定：
		(i) 倘二零二零年六月一日上午十一時正（倫敦時間）的3個月美元LIBOR小於或等於4.00%並且高於或等於-3.00%，則預期年收益率將為3.40%；
		(ii) 倘二零二零年六月一日上午十一時正（倫敦時間）的3個月美元LIBOR高於4.00%，則預期年收益率將為3.85%；或
		(iii) 倘二零二零年六月一日上午十一時正（倫敦時間）的3個月美元LIBOR小於-3.00%，則預期年收益率將為1.50%。

投資範圍：該產品為結構性產品，將全部資金用來投資於其中嵌入與(其中包括)利率、匯率及指數掛鈎的金融衍生產品的存款。

提前終止：華虹無錫無權於到期日前撤回任何本金。

認購金融產品之理由及裨益

本公司認為，金融產品將為銀行發行之保本、短期及低風險投資產品，可提供較銀行或持牌金融機構現時提供定期存款利率更為優厚之利率。董事認為，認購金融產品將可有效利用華虹無錫所持現金，並於未來一年至兩年內將現金用作資本及經營開支前獲得安全及有吸引力之回報。因此，董事認為，認購金融產品符合一般商業條款及屬公平合理，並符合本集團及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於(i)二零二零年二月中信結構性存款產品協議及(ii)二零二零年四月中信結構性存款產品協議各自之適用比率低於5%，故按單獨基準計算，該等認購事項並不構成本公司之須予披露交易。

由於有關交易乃與同一銀行訂立且性質類似，故(i)二零二零年二月中信結構性存款產品協議及(ii)二零二零年四月中信結構性存款產品協議將根據上市規則第14.22條於計算相關百分比率時合併計算及處理，猶如本公司與中信銀行之一項交易。

由於有關(i)二零二零年二月中信結構性存款產品協議及(ii)二零二零年四月中信結構性存款產品協議按合併基準計算之適用百分比率超過5%但低於25%，該等交易構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章之申報及公告規定。

在所有相關時間，從中信銀行購買的所有金融產品的適用百分比率在任何時間均分別不會超過25%。

有關訂約方之資料

本公司

本公司為特種應用之半導體（主要為8英寸(200mm)晶圓）製造商。本公司之技術，尤其是嵌入式非易失性存儲器(eNVM)及功率器件，主要應用於消費者電子、通訊、計算及工業以及汽車行業。

華虹無錫

華虹無錫目前為本公司之非全資子公司，主要從事12英寸(300mm)晶圓集成電路之設計、研究、製造、測試、封裝及銷售業務。

中信銀行

中信銀行原稱中信實業銀行，創立於一九八七年，二零零五年年底改為現名。中信銀行是中國的全國性商業銀行之一，總部位於北京，主要股東是中國中信股份有限公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中信銀行及其最終實益擁有人為獨立於本集團及其關連人士之第三方。

承董事會命
華虹半導體有限公司
張素心先生
董事長兼執行董事

中國上海，二零二零年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事：

杜洋

森田隆之

王靖

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩，太平紳士

葉龍蜚